【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和3年11月11日(2021.11.11)

【公表番号】特表2021-500247(P2021-500247A)
【公表日】令和3年1月7日(2021.1.7)
【年通号数】公開・登録公報2021-001
【出願番号】特願2020-521879(P2020-521879)
【国際特許分類】
Ｂ２９Ｄ　30/38　(2006.01)
Ｂ６０Ｃ　9/04　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ２９Ｄ　30/38
Ｂ６０Ｃ　9/04　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和3年9月29日(2021.9.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
タイヤ（４）のためのサブアセンブリ（３）を製造する方法（Ｓ）であって、
第１の構造体（１０）、第２の構造体（１２）、及び支持構造体（１４）を含むアセンブリを提供する段階であって、
前記第１の構造体（１０）が、フィラメント状要素によって形成され、かつ第１の軸線（１１）を定める第１の方向に延びる長手縁部（１０ａ、１０ｂ）を有し、
前記第２の構造体（１２）が、フィラメント状要素によって形成され、かつ第２の軸線（１３）を定める第２の方向に延びる長手縁部（１２ａ、１２ｂ）を有し、
前記支持構造体（１４）が、前記第１の構造体（１０）及び前記第２の構造体（１２）をつなぐ支持フィラメント状要素を含む、段階と、
前記第１の軸線（１１）及び前記第２の軸線（１３）が実質的に平行であるように前記第１の構造体（１０）を前記第２の構造体（１２）上に位置決めする段階（Ｓ１）と、
前記第１の構造体（１０）を前記第２の構造体（１２）に対して定位置に保持し、かつアセンブリ（１）を取得するために該第２の構造体（１２）に対する該第１の構造体（１０）のいずれの移動も防止するように、固定要素（１８）を使用して該第１の構造体（１０）を該第２の構造体（１２）の上にしっかりと固定する段階（Ｓ４）と、
前記固定要素（１８）を前記アセンブリ（１）の残りから分離し、かつ固定要素（１８）のない少なくとも１つのサブアセンブリ（３）を取得するように、該固定要素（１８）に沿って該アセンブリ（１）を切断する段階（Ｓ５）と、
を含むことを特徴とする方法（Ｓ）。
【請求項２】
前記固定する段階（Ｓ４）の前に、前記第１の軸線（１１）及び前記第２の軸線（１３）が重ね合わされる段階（Ｓ２）を更に含む、請求項１に記載のサブアセンブリ（３）を製造する方法（Ｓ）。
【請求項３】
前記第１の構造体（１０）及び前記第２の構造体（１２）の各々が、それらのそれぞれの長手縁部（１０ａ、１０ｂ、１２ａ、１２ｂ）に対して横断方向に延びる横断縁部（１

０ｃ、１２ｃ、１０ｄ、１２ｄ）を含み、
方法が、前記固定する段階（Ｓ４）の前に、前記第１の構造体（１０）の前記横断縁部（１０ｃ、１０ｄ）及び前記第２の構造体（１２）の該横断縁部（１２ｃ、１２ｄ）が重ね合わされる段階（Ｓ３）を更に含む、請求項１又は２に記載のサブアセンブリ（３）を製造する方法（Ｓ）。
【請求項４】
前記第１の構造体（１０）は、２つの対向する横断縁部（１０ｃ、１０ｄ）を有し、該横断縁部は、該第１の構造体の前記長手縁部（１０ａ、１０ｂ）に対して横断方向に延び、該第１の構造体（１０）の長さ（Ｌ）が、該第１の構造体（１０）が扁平に置かれた時にその横断縁部（１０ｃ、１０ｄ）間の短い方の距離に等しく、該第１の構造体（１０）は、その長さ（Ｌ）の全て又は一部にわたって前記第２の構造体（１２）の上に固定される（Ｓ４）、請求項１から３のうちの１項に記載のサブアセンブリ（３）を製造する方法（Ｓ）。
【請求項５】
前記第１の構造体（１０）は、その長さ（Ｌ）の全て又は一部にわたって前記第１の軸線（１１）と平行な方向に前記第２の構造体（１２）の上に固定される（Ｓ４）、請求項４に記載のサブアセンブリ（３）を製造する方法（Ｓ）。
【請求項６】
前記第１の構造体（１０）は、その長さ（Ｌ）の少なくとも５０％にわたって前記第２の構造体（１２）の上に固定される（Ｓ４）、請求項５に記載のサブアセンブリ（３）を製造する方法（Ｓ）。
【請求項７】
前記第１の構造体（１０）は、前記固定要素（１８）が、互いの延長に延びる少なくとも２つの隣接セグメントを含むように、前記第２の構造体（１２）の上に非連続的に固定される（Ｓ４）、請求項６に記載のサブアセンブリ（３）を製造する方法（Ｓ）。
【請求項８】
前記第１の構造体（１０）は、接着、溶接、縫い合わせのうちの少なくとも１つを使用して前記第２の構造体（１２）の上に固定される（Ｓ４）、請求項１から７のうちの１項に記載のサブアセンブリ（３）を製造する方法（Ｓ）。
【請求項９】
前記第１の構造体（１０）は、少なくとも２つの異なる固定要素（１８）を使用して前記第２の構造体（１２）にしっかりと固定される（Ｓ４）、請求項１から８のうちの１項に記載のサブアセンブリ（３）を製造する方法（Ｓ）。
【請求項１０】
前記切断する段階（Ｓ５）は、
前記固定要素（１８）を第１の切断線に沿って切断し、固定要素（１８）なしに前記サブアセンブリ（３）を取得するサブステップと、
前記固定要素（１８）を第２の切断線に沿って切断し、それを前記アセンブリ（１）の残りから分離して第２のサブアセンブリ（３）を形成するサブステップと、
を含む、
請求項１から９のうちの１項に記載のサブアセンブリ（３）を製造する方法（Ｓ）。